BaKon®

PROFESYONEL TAMİR | DAHA GÜVENİLİR YARINLAR

BK8860

BGA REWORK İSTASYONU

Profesyonel Chipset Tamir Cihazı

7 inç DOKUNMATİK ENDÜSTRİYEL LCD
Kolay ve akıllı kontrol

LAZER HİZALAMA
Hassas konumlandırma

AKILLI PID SICAKLIK KONTROLÜ
±3°C hassasiyet ile stabil performans

MANUEL VAKUM
Güvenli BGA sökme işlemleri

GÜVENLİK KORUMASI
Aşırı ısı koruması, acil stop ve sesli uyarı sistemi

3 BÖLGELİ BAĞIMSIZ ISITMA SİSTEMİ

Hassas kontrol, dengeli ısı dağılımı, mükemmel sonuçlar.

ÜST ISITICI
Güçlü sıcak hava ile hassas ısıtma kontrolü

IR ÖN ISITMA
375 × 285 mm geniş IR alan ile homojen ısı dağılımı

ALT ISITICI
Güçlü alt ısıtma ile kartın alt yüzeyinde dengeli ısı kontrolü



PROFESYONELLERİN TERCİHİ

Yüksek performans, hassas kontrol ve güvenli çalışma. BK8860 ile profesyonel çözümler bir arada.

CE | 36 AY GARANTİ

MAKS. PCB BOYUTU	UYGUN ÇİP BOYUTU	IR ISITMA ALANI	SICAKLIK HASSASİYETİ	PROFİL HAFIZASI	8 KADEMELİ SICAKLIK PROFİLİ
410 × 370 mm	10 × 10 – 40 × 40 mm	375 × 285 mm	±3°C	30 ADET	

KULLANIM ALANLARI

GENİŞ UYGULAMA ALANLARI | FARKLI SEKTÖRLERDE GÜVENİLİR ÇÖZÜM


LAPTOP ANAKART TAMİRİ


GPU / VGA TAMİRİ


CPU / CHİPSET REWORK


OYUN KONSOLU TAMİRİ


ENDÜSTRİYEL KART ONARIMI

BaKon®

PROFESYONEL TAMİR | DAHA GÜVENİLİR YARINLAR

BK8860
BGA REWORK İSTASYONU

GELİŞMİŞ IR ÖN ISITMA TEKNOLOJİSİ

BK8860, 375 × 285 mm geniş IR ön ısıtma alanı ile PCB yüzeyine homojen ısı dağılımı sağlayarak kartın eğilmesini azaltır, BGA sökme/takma işlemlerinde daha yüksek kalite, stabilite ve güvenilir sonuçlar sunar.



GENİŞ ÖN ISITMA ALANI

375 × 285 mm geniş IR ön ısıtma alanı, büyük boy PCB'lerde homojen ısı dağılımı sağlar.

KART EĞİLMESİNİ AZALTIR

Tüm PCB yüzeyinin eşit ısıtılması ile kartın eğilmesini ve termal stresi minimize eder.

GÜVENLİ BGA SÖKME/TAKMA

Stabil ve kontrollü sıcaklık profili ile daha güvenli rework operasyonları sağlar.

PROFESYONEL AKIŞ PROFİLİ

PID kontrollü sistem, hassas ve tekrarlanabilir sıcaklık profilleri oluşturur.

BÜYÜK ÖN ISITMA ALANI



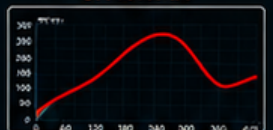
375 × 285 mm geniş IR ön ısıtma alanı

HOMOJEN ISI DAĞILIMI



Tüm yüzeyde yüksek düzgünlükte ısı dağılımı

PID KONTROLLÜ ÖN ISITMA



Hassas ve stabil sıcaklık kontrolü

GÜVENLİ VE STABİL REWORK



Bileşenleri korur, güvenilir çalışma ortamı sağlar

YÜKSEK PERFORMANS



Optimize edilmiş akış profilleri ile maksimum başarı

BaKon®

PROFESYONEL TAMİR | DAHA GÜVENİLİR YARINLAR

BK8860
BGA REWORK İSTASYONU

AKILLI PID SICAKLIK KONTROL SİSTEMİ

BK8860'da kullanılan akıllı PID kontrollü sıcaklık sistemi; gerçek zamanlı sıcaklık takibi, stabil termal yönetim, hassas ısı geçişleri, kontrollü soğutma ve detaylı sıcaklık eğrisi analizi ile her işlemde tekrarlanabilir ve yüksek kaliteli sonuçlar sağlar.



GERÇEK ZAMANLI SICAKLIK TAKİBİ
Anlık sıcaklık verileriyle süreç her saniye izlenir.

STABİL SICAKLIK YÖNETİMİ
PID algoritması ile sıcaklık dalgalanmaları en aza indirilir, stabil ısı ortamı sağlanır.

HASSAS ISI GEÇİŞLERİ
Isı rampaları milisaniye seviyesinde kontrol edilerek bileşenlere zarar verme riski azaltılır.

KONTROLLÜ SOĞUTMA
İşlem sonrası kontrollü soğutma ile PCB ve bileşenlerin ömrü uzar.

SICAKLIK EĞRİSİ ANALİZİ
Detaylı sıcaklık eğrisi kaydı ve analizi ile her işlemde maksimum başarı sağlanır.

GERÇEK ZAMANLI SICAKLIK EĞRİSİ



MEVCUT SICAKLIK **217°C**

HEDEF SICAKLIK **215°C**

ISITMA GÜCÜ **68%**

SICAKLIK SAPMASI **±1.2°C**

PROFESYONEL REFLOW PROFİLİ

1. ÖN ISITMA	2. ISITMA	3. SOAK	4. RAMP UP	5. REFLOW	6. SOAK	7. COOLING	8. END
150°C	**180°C**	**150~180°C**	**1~3°C/sn**	**220~245°C**	**220~200°C**	**2~4°C/sn**	**<100°C**
Yavaş ön ısıtma ile termal şok önlenir.	Sıcaklık kademeli olarak yükseltilir.	Flux aktivasyonu ve ısı dengelenmesi sağlanır.	Kontrollü hızlı ısı artışı yapılır.	BGA lehim erime noktası, maksimum ısı bölgesi.	Lehim akışının dengelenmesi sağlanır.	Kontrollü soğutma ile dayanıklılık artırılır.	Güvenli sıcaklık seviyesine dönülür.

DAHA GÜVENLİ
PCB eğilmesini ve katman ayrılma riskini azaltır.

YÜKSEK HASSASİYET
Kritik BGA bileşenlerde üstün işlem kontrolü sağlar.

MAKSİMUM BAŞARI
Doğru ısı profili ile rework başarı oranını artırır.

ZAMAN TASARRUFLU
Otomatik kontrol ile işlem sürelerini optimize eder.

KOMPONENT KORUMA
Aşırı ısı dalgalanmalarını önleyerek bileşenlerin ömrünü uzatır.

BaKon®

PROFESYONEL TAMİR | DAHA GÜVENİLİR YARINLAR

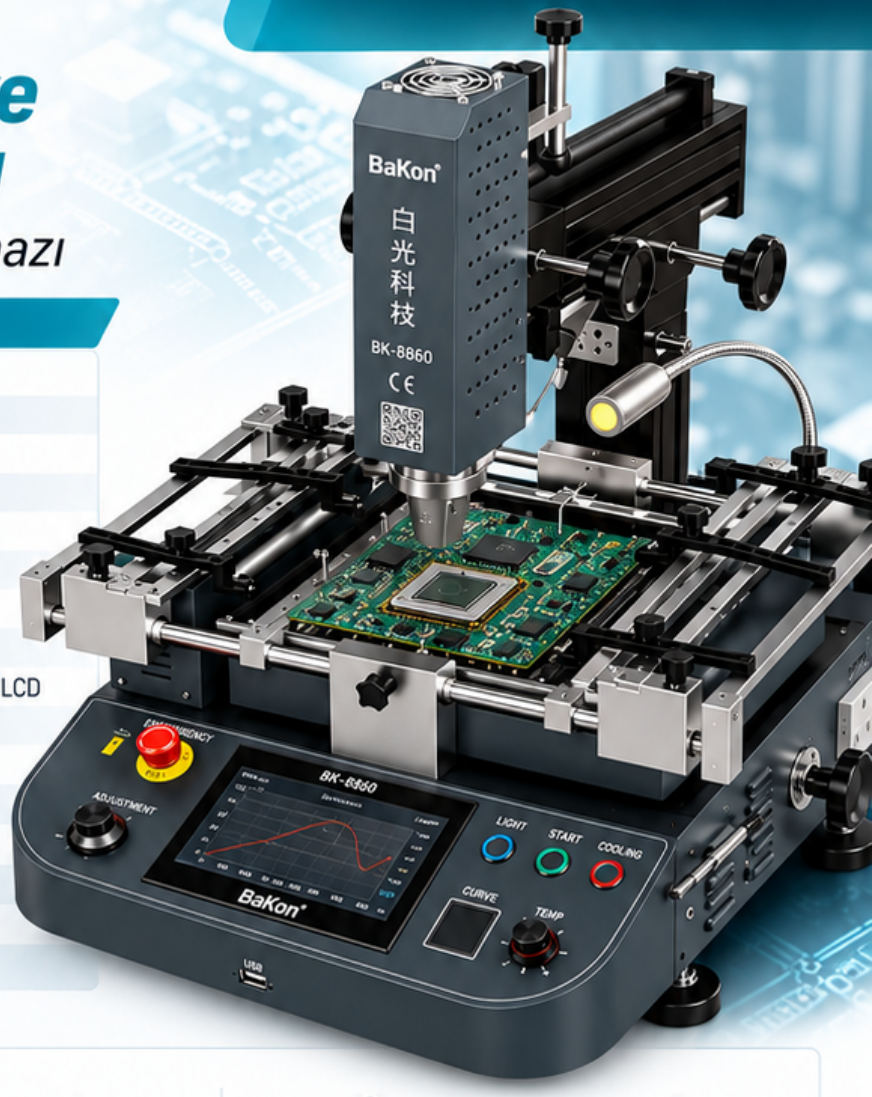
BK8860

Teknik Özellikler ve Uygulama Alanları

Profesyonel Chipset Tamir Cihazı

YÜKSEK PERFORMANS
DAHA GENİŞ OLANAKLAR

BK8860, hassas sıcaklık kontrolü, stabil ısı dağılımı ve profesyonel rework işlemleri için geliştirilmiş tam donanımlı bir BGA tamir istasyonudur.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Marka / Model	Bakon / BK8860
Güç Girişi	AC 220 V ±10% / 50–60 Hz
Maksimum Toplam Güç	5 kW
Üst / Alt / IR Isıtıcı	0,8 / 1,2 / 2,7 kW
Maksimum / Minimum PCB	410 × 370 mm / 10 × 10 mm
Uygun Çip Boyutu	10 × 10 mm – 40 × 40 mm
IR Isıtma Alanı	375 × 285 mm
Kontrol Sistemi	Otomatik PID
Ekran	7 inç Dokunmatik Endüstriyel LCD
Hizalama Sistemi	Lazer Hizalama
Vakum Sistemi	Manuel
Sıcaklık Hassasiyeti	±3°C
Profil Hafızası	30 Adet
Ölçüler (G × D × Y)	635 × 620 × 655 mm
Ağırlık	43,5 kg
Garanti	36 Ay

ÜRÜN AVANTAJLARI

YÜKSEK HASSASİYET
±3°C sıcaklık hassasiyeti ile güvenilir ve tekrarlanabilir rework sonuçları

STABİL PERFORMANS
PID kontrollü sistem ile dengeli ısı dağılımı ve kararlı işlem süreci

GENİŞ UYUMLULUK
Farklı boyut ve tipteki PCB'ler için esnek kullanım imkanı

GÜVENLİ VE KONTROLLÜ
Aşırı ısı koruması, acil stop ve sesli uyarı sistemi

PROFESYONEL DONANIM
7 inç dokunmatik ekran, lazer hizalama ve manuel vakum sistemi

BAŞLICA KULLANIM ALANLARI


LAPTOP ANAKART TAMİRİ


EKRAN KARTI GPU REWORK


OYUN KONSOLU TAMİRİ


ENDÜSTRİYEL PCB


AR-GE VE PROTOTİPLEME

KUTU İÇERİĞİ

BGA rework sistemi, ayarlanabilir PCB sabitleme aparatları, manuel vakum aparatı, harici sıcaklık sensörü, güç kablosu ve kullanım kılavuzu.
Kutu içeriği üretici revizyonlarına göre değişebilir.

İLAVE KONTROL ÖZELLİKLERİ

- B b bnobcjhmop !mf bgj j! 4 6 n n +
- VTCl f joef b KQH gp n b oeb f j lb b n +
- jgf! l p n b!rh jJ jrl f! dlb lhn b bnn +

!+Hm bo rl h f jmf! ı ı b cj hjng ı oef! cf jmj fnb f jmfmy